

## 問題 5

I. 固体中の電子を考える. 固体中の電子のシュレディンガー方程式は,

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi \quad (i)$$

と記述できるとする. ただし,  $t$ は時間,  $\Psi$ は電子の波動関数,  $H$ は電子に対するハミルトニアン,  $i$ は虚数単位,  $\hbar = h/2\pi$ であり,  $h$ はプランク定数とする. 以下の間に答えよ. ただし,  $E$ は電子のエネルギーであり,  $\omega = E/\hbar$ ,  $k$ は電子の波数(実数)とする.

(1) ハミルトニアンが  $H = -A \frac{\partial^2}{\partial x^2}$  と表されるとする. ただし,  $A$ は正の実数の定数,  $x$ は位置

とする. 波動関数が  $\Psi = Ce^{i(kx - \omega t)}$  と記述できるとする. ただし,  $C$ は定数である.

(1-i)  $E$  と  $k$  の間の分散関係を求めよ.

(1-ii) 固体中の電子は有効質量  $m$  を持った自由電子として表すことができる. このとき, 有効質量  $m$  を求めよ. ただし, 電子の運動量は  $\hbar k$  で与えられる.

(1-iii) 長さ  $L$  の 1 次元の固体を考える. このとき, この固体中で取りうる  $k$  を求めよ. ただし, 周期  $L$  の周期的境界条件を仮定してよい.

(1-iv) 問(1-iii)の結果を用いて, 1 次元の固体中でのエネルギー  $E$  における電子の状態密度を求めよ.

(2) ハミルトニアンが  $H = -A \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$  と表されるとする. ただし,  $A$ は正の実数の定

数,  $x, y$  および  $z$  は位置とする. 波動関数が  $\Psi = Ce^{i(k_x x + k_y y + k_z z - \omega t)}$  と記述できるとする.

ただし,  $C$  は定数,  $k_x, k_y$  および  $k_z$  はそれぞれ  $x$  方向,  $y$  方向および  $z$  方向の波数成分である. このとき, 3 次元の固体中でのエネルギー  $E$  における電子の状態密度を求めよ.

(3) ハミルトニアンが  $H = \begin{pmatrix} 0 & Bk \\ Bk & 0 \end{pmatrix}$  と記述されると仮定する. ただし,  $B$  は正の実数とする.

このとき, 電子のシュレディンガー方程式は,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle = H|\Psi\rangle, \quad (ii)$$

と記述できるとする. ただし,  $|\Psi\rangle$  は電子の状態ベクトルとする.

(3-i) 状態ベクトルが  $\Psi = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} e^{-i\omega t}$  と表されるとする. ただし,  $\varphi_1$  および  $\varphi_2$  は時間に依存しない値である. このとき,  $E$  と  $k$  の間の分散関係を求めよ.

(3-ii) 電子の伝搬する速さ ( $= dE/dk$ ) を求めよ. また, この電子と自由電子の差異について論ぜよ.

II. 図 1 に示すシリコン (Si) pn 接合に電圧  $V$  を印加することを考える。n 型 Si および p 型 Si は均一にリン (P) およびボロン (B) が添加されており、それぞれの不純物密度を  $N_D$ ,  $N_A$  とする。不純物のイオン化率は 100% とする。 $x$  は位置であり、n 型 Si と p 型 Si の境界を  $x = 0$  とする。空乏層端の位置をそれぞれ  $x = -l_n$ ,  $x = l_p$  とする。また、 $k_B$  はボルツマン定数、 $q$  は素電荷、 $T$  は PN 接合の温度、 $\epsilon_s$  は Si の誘電率、 $n_i$  は Si の真性キャリア密度とする。

以下の間に答えよ。ただし、 $T$  は室温とする。

- (1)  $V = 0$  のときの pn 接合のバンド図を示せ。ただし、フェルミ準位  $E_F$  と真性フェルミ準位  $E_i$  を明記すること。
- (2) pn 接合の内蔵電位  $V_{bi}$  を求めよ。ただし、熱平衡状態における電子密度は  $n_i e^{(E_F - E_i)/kT}$ 、ホール密度は  $n_i e^{(E_i - E_F)/kT}$  と表せるとする。
- (3)  $V = 0$  のときの空乏層内における静電ポテンシャルおよび電界の分布を  $l_n$ ,  $l_p$  を使って求め、図示せよ。ただし、n 型中性領域および p 型中性領域の電界はゼロと仮定してよい。
- (4)  $V = 0$  のときの空乏層幅  $W = l_n + l_p$  を内蔵電位  $V_{bi}$  を使って表せ。
- (5) 順バイアス ( $V > 0$ ) 時のバンド図を示し、電流が  $V$  に対して指数関数的に増加する理由を、伝導帶中の電子のエネルギー分布を使い説明せよ。
- (6) 逆バイアス ( $V \ll 0$ ) 時は、ゼロではない一定の電流が流れる。この理由を中性領域における少数キャリア分布から説明せよ。
- (7) Si 中に結晶欠陥が均一に存在する場合を考える。結晶欠陥は電子とホールの生成・再結合中心となり、単位体積当たりの実効再結合速度は  $\frac{np - n_i^2}{n + p + 2n_i} \cdot \frac{1}{\tau}$  で与えられる。ただし、 $n$  は電子密度、 $p$  はホール密度、 $\tau$  はキャリア寿命である。このとき、逆バイアス印加時に流れる生成電流密度を空乏層幅  $W$  を使って求めよ。

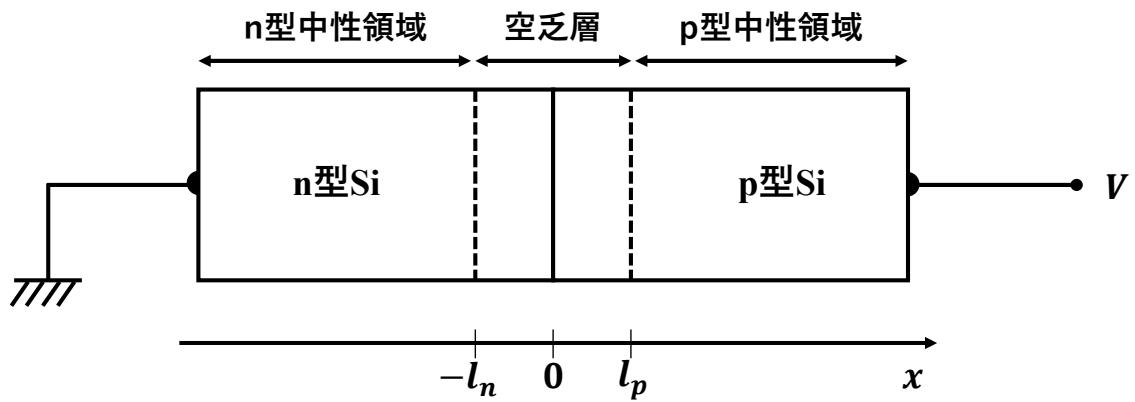


図 1